

## TOPPAN、「電子機器トータルソリューション展 2024」に出展 TOPPAN の半導体パッケージにおける最新の技術開発の取り組みを紹介

TOPPAN ホールディングスのグループ会社である TOPPAN 株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:齊藤 昌典、以下 TOPPAN)は、2024年6月12日(水)から14日(金)に開催される「電子機器トータルソリューション展 2024」(会場:東京ビッグサイト)に出展します。

本展示会は、あらゆる電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路・実装技術や、用途の広がりを見せるセンサー・E-Textile (ウェアラブル技術) 等、新しいコンテンツとソリューションなどの展示に加え、技術情報の提供・提案をはかり、あわせて電子回路業界および関連業界全体の発展に寄与する、国内外に広く認知される展示会です。

TOPPAN ブースでは、FC-BGA 基板や、コアレス有機インターポージャー、ガラスパネル基板、LSI ターンキーサービスなどの展示・紹介を行います。また、6月14日には、出展社プレゼンテーションとして、セミナーを開催します。



### ■ 主な展示内容

#### ① FC-BGA 基板

FC-BGA (Flip Chip-Ball Grid Array) 基板は、LSI チップの高速化、多機能化を可能にする高密度半導体パッケージ基板です。TOPPAN は、ビルドアップ配線技術を独自に発展させた超高密度配線構造のサブストレートを開発、半導体プロセスの微細化に対応した製品を提供しています。サーバー用 CPU、AI アクセラレーター、ネットワーク機器向けのハイエンドプロセッサをはじめ、幅広い用途向け LSI の多彩な要求に対し、設計から製造まで顧客のニーズをトータルにサポートします。

#### ② コアレス有機インターポージャー<sup>※1</sup>(初出展)

インターポージャーには、接続の信頼性から、チップの熱膨張係数(CTE)に近づける低 CTE 化、IO(入出力)数増大による微細接続、搭載チップ数増大による大型化が要求されています。それらの課題解決に貢献する、TOPPAN が開発したシンプルなコアレス構造の有機インターポージャーを紹介します。

### ③ ガラスパネル基板(初出展)

TOPPAN 独自のガラス加工技術を活かして、ガラスパネルに貫通孔と部品搭載用キャビティを形成します。FC-BGA 基板やインターポザーへの適用を予定しています。

### ④ パワー半導体/ターンキーサービス

LSI デザインパートナーとして 50 年以上の実績のある TOPPAN のデバイスソリューションに、国内ファウンドリメーカーとの協業によるパワー半導体向けターンキーサービスが新たに加わりました。

### ⑤ 銀焼結接合材

パワー半導体の小型化に伴う発熱密度の上昇により、はんだよりも高放熱・高耐熱な実装材料が求められています。TOPPAN 独自の材料技術を活用して開発した銀焼結接合材を紹介します。

## ■ セミナー情報

- ・日時:2024 年 6 月 14 日(金)16:20~16:40
- ・会場:東京ビッグサイト 東 3 ホール セミナー会場 D(NPI セミナー会場)
- ・タイトル:「ヘテロジニアスインテグレーション向け再配線層内蔵コアレス基板(有機インターポザー)のご紹介」
- ・登壇者:エレクトロニクス事業本部 次世代半導体パッケージ開発センター 課長 高城総夫

## ■ 「電子機器トータルソリューション展 2024」について

- ・会期: 2024 年 6 月 12 日(水)~14 日(金)10:00~17:00
- ・会場:東京ビッグサイト 東ホール  
※TOPPAN は「JPCA Show 2024」に出展(東 3 ホール/小間番号 3A-28)
- ・主催: 一般社団法人日本電子回路工業会、一般社団法人エレクトロニクス実装学会、一般社団法人日本ロボット工業会
- ・公式サイト:<https://www.jpca-show.com/show2024/jp/exhibition/index.html>

## ■ 「Smart Sensing 2024」について

「電子機器トータルソリューション展 2024」と同日程、同会場で開催される「Smart Sensing 2024」においても、TOPPAN が開発した「DSC(色素増感太陽電池)」を利用した EH 型電源モジュールおよびセンサモジュール」を初出展します。

(会場:東京ビッグサイト東 5 ホール/小間番号 No.5E-62(次世代センサパビリオン内))

注 1:貫通電極によって表裏の回路を電氣的に接続するために用いられる基板

\* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

\* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上